

品質管理

ISO9001 認証取得



品質理念

お客様の信頼と満足を第一とし、
ダイシング加工による最高の
品質の製品実現をめざします。



天井へパフィルター

品質方針

- お客様のニーズに適合し、且つお客様の利益に貢献できる技術とサービスの提供に努めます。
- 常に作業改善に努め、変化に対応できる技術を提供します。
- 5S と TAT を誇る工場づくりに努めます。

作業環境

項目	管理値
クリーン度	クラス 500 (0.5 ミクロン) (実績：外観室 100 以下 / ダイシング室 300 以下)
温度	22~28℃
湿度	40~65%
静電気帯量	200v 以下
超純水	生菌数 0 比抵抗 18MΩ以上



クリーンルーム全般

品質管理

ISO14001 認証取得



環境理念

多摩の緑豊かな自然を配慮した地球環境づくりを推進し、ダイシング加工の事業活動を通じて私たちの技術力を有効活用し「環境と付き合うサンテック」をテーマに掲げ、自然と企業が共存できる潤いと豊かさをもった優しい環境社会づくりに努めます。

環境方針

- 国、地方自治体等の環境関連法規制および協定を順守し、環境保全に努めます。
- 事業活動に於いて、環境に与える影響を評価し、著しい環境側面に対して環境目的・目標を定め、従業員全員でこの目標の達成に向けて取り組みます。
- 環境保全の配慮から電力と水の有効活用及び環境負荷を考慮し安全に利用できる資材の選定を行います。
- 加工の過程で排出される産業廃棄物の分別、削減を図ると共に汚染の防止に努めます。
- 全ての従業員に対して、環境方針の周知徹底と必要な教育・訓練を行います。

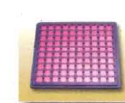
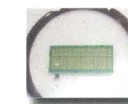
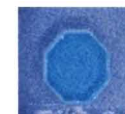
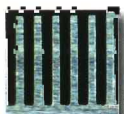
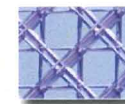
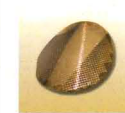
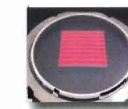


 **株式会社 サンテック**

〒190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-1-10
TEL 042-557-7744 (代)
FAX 042-557-7745
E-mail : suntec@c-suntec.co.jp
URL : <http://www.c-suntec.co.jp>

SUNTEC

テクニカルサポート



 **株式会社 サンテック**

URL : <http://www.c-suntec.co.jp>



加工技術紹介

加工工程

製品受入

BG, CMP 加工
リング固定方式
25 μ m 対応

ダイシング

0.3mm \square 対応

トレー詰め

0.3mm \square (30 μ m 厚) ピックアップ

外観検査

金属顕微鏡 / 実体顕微鏡

作業の流れ
(フロー)

包装・出荷

Si, ガラス
セラミック
石英
特殊素材, 等

主な加工技術一覧

材料	技術	BG (個片BG含む)	CMP	ダイシング (特殊加工含む)	ソート	外 観
シリコン基盤		●	●	●	●	●
ガラス基板		●		●	●	●
ガラエポ基板				●	●	●
セラミック (窒化アルミ、アルチック) 基板		●		●	●	●
ステンレス基板				●	●	●

半導体シリコン加工

BG 加工

シリコンウェハの超薄型研削
研磨後のダメージを軽減

微細チップの選別 (0.3mm/m 角チップ)

ガラス加工

(ブルーガラス)

(特殊ガラス)

面取り加工 (R角形)

(光学ガラス)

基板加工

(小型樹脂基板)

LED 基板加工

特殊加工

[溝入れ加工]

25 μ m 幅溝入

[多角形加工]

ダイシング加工

切断技術

	ストレート	ステップ	上面ベベル	両面ベベル	多段カット
断面図					
シリコン	●	●	●	●	●
ガラエポ基板	●	●	●	●	●
ガラス	●	●	●	●	●
セラミック	●	●	●	●	●
他	●	●	●	●	●

比較 (出来栄)

汚れ	●	●	●	●	—
異物	●	●	●	●	—
表面チッピング	●	●	●	●	—
裏面チッピング	●	●	●	●	—
クラック	●	●	●	●	—
特徴	低コスト 短 TAT 表裏チッピング (5~30 μ m)	精密溝入れ (幅~25 μ m) 表裏チッピングの抑制 (1~10 μ m)	切断面のカケ抑制 表面チッピングの抑制 (0~5 μ m)	切断面のカケ抑制 浮遊異物の抑制 表裏チッピングの抑制 (0~5 μ m)	異なる材質の多層構造 *各層で砥石(ブレード) を変更
用途	加工全般 Si ガラエポ ラミネート	汎用、産業用半導体 Si 炭化珪素 サファイア	コート付ガラス ブルーガラス Si Si (スペーサー)	多層膜ガラス ブルーガラス Si (スペーサー)	貼り合せ基板 複合多層基板

●...サンテック 特殊技術

BG/CMP加工

対応表

	サイズ (in)	サイズ (角)	粗削り (#360)	仕上げ研削		ポリッシング (鏡面)
			#360	#2000	#8000	
シリコン	~12インチ (注1)	~140mm 角	●	●	●	●
セラミック	~12インチ (注1)	~140mm 角	●	—	—	—

※注1: 8インチを超える場合、ダイシングにて分割を行います。

技術

	薄型	突起部高さ (パンプ等)
シリコン	30 μ m	~100 μ m
セラミック		~100 μ m

<特徴>

- 突起部のある製品の薄型化が行えます。
- 超薄型 (25 μ m) の BG・ポリッシング加工が行えます。

<特殊加工>

- マルチ加工: ダイシング加工と組み合わせ、1枚のウェハから異なる仕上げ厚 (マルチ研削) が行なえます。
- チップの薄型化: チップ化された製品 (1チップでも) を薄くしたい、また、割れているウェハを救済したい、等の製品薄型化が可能です。